Tecdia Co.,Ltd.

Company Description

5G・データセンター・宇宙開発から、スマートフォン・3Dプリンティングまで、未来に向けて必要な製品を供給するメーカーです。“Work Hard Play Hard”をモットーに、仕事だけでなくプライベートの充実も追求する会社です。

半導体組立技術（CM事業）
フィリピン・セブ島で、通信技術の要である半導体部品の製造を行っています。フィリピンは世界の中でもトップクラスの海外生産先として知られ、手先の器用さ、英語でのコミュニケーションなど、地の利を生かしたものづくりを行っています。

セラミック応用技術
セラミックを用いた電子部品がテクダイヤの主力製品です。用途は5G通信、衛星または世界のデータセンターほか半導体通信市場。グローバルニッチ市場でシェアナンバー1を獲得しています。

精密機械加工技術
機械加工とは、金属などを専用機械で様々な形状に加工することです。この技術を使ったミクロン単位での精巧なものづくりが、スマートフォン、液晶タブレット、3Dプリンティングなどに寄与しています。

ダイヤモンド応用技術
ダイヤモンドの卸売りから始まったテクダイヤは、ダイヤ加工技術を確立し、ダイヤモンド製工具の製造・販売を行う世界有数の企業です。LEDやBlu-Rayなど、様々な業界に製品提供を行っています

＜当社の魅力＞
当社は、電子部品・精密部品・半導体の開発・製造・販売を行うニッチトップのグローバルメーカーです。
セラミックを用いた電子部品が主力製品で、5G通信、世界のデータセンター、半導体通信市場で幅広く当社の製品が採用されています。精密機械の加工技術の高さも特徴で、ミクロン単位での精巧な技術力が、スマホや液晶タブレット等に寄与しています。

Company Details

Head Office
Japan

Main Business
半導体系電子部品の製造・開発

President
小山真吾

Established
1976年6月

Capital
60,000,000円

Number of Employees
51 - 100

URL
https://www.tecdia.com/jp/

Offices

Main Office
Shibaura Square Building, 17th Floor
4-9-25 Shibaura, Minato-ku
Tokyo, Japan, 1080023